

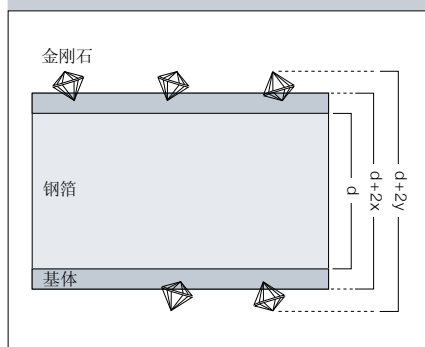


EKagrip® 技术数据

功能特征	提高摩擦系数的化学镍 / 金刚石涂层 EKagrip®		
材料特性*	EKagrip® 10	EKagrip® 25 PLUS	EKagrip® 35 PLUS
供货方式	带有 EKagrip® 10 涂层的垫片	带有 EKagrip® 25 PLUS 涂层的垫片	带有 EKagrip® 35 PLUS 涂层的垫片
硬质材料	金刚石	金刚石	金刚石
中等粒度	10 μm	25 μm	35 μm
金刚石表面装备密度 (平均值)	8 – 16 %	8 – 25 %	10 – 30 %
基体材料	化学镍磷	化学镍磷	化学镍磷
基体层厚度 x	5 – 9 μm	13 – 17 μm	14 – 22 μm
总层厚度 y	10 – 20 μm	25 – 35 μm	35 – 50 μm
热处理	150 °C / 350 °C ± 10 °C	150 °C / 350 °C ± 10 °C	150 °C / 350 °C ± 10 °C
镍磷基体硬度	约 600/ 900 HV 0.03	约 600/ 900 HV 0.03	约 600/ 900 HV 0.03
设色	金属银灰色	金属银灰色	金属银灰色
薄膜材料 (首选)	C 75 S (根据 EN 10132-4)	C 75 S (根据 EN 10132-4)	C 75 S (根据 EN 10132-4)
薄膜厚度 d	标准 0.1 mm ± 0.01 mm (其他厚度请洽询)	标准 0.1 mm ± 0.01 mm (其他厚度请洽询)	标准 0.1 mm ± 0.01 mm (其他厚度请洽询)
镀膜后总厚度 (在薄膜 0.1 mm ± 0.01 mm)	0.13 mm ± 0.02 mm	0.16 mm ± 0.02 mm	0.185 mm ± 0.025 mm
基体材料的加工	激光切割或者冲压	激光切割或者冲压	激光切割或者冲压
对面 (和加工方向垂直) 的表面粗糙度 Rz	Rz << 10 μm	Rz << 25 μm	Rz << 35 μm
最低表面压力	p > 50 MPa	p > 50 MPa	p > 50 MPa
最高工作温度	400 °C	400 °C	400 °C

* 这些数据是参考值。在需要时，我们可以提供用于确定规格的图纸框。

模式图 EKagrip® 摩擦片



本文数据基于当前我们所知的范畴，但不免除用户在收到后立刻仔细核对对所有来源数据的义务。在技术进步和新产品开发的情况下，我们保留变更产品参数的权利。本文建议应当通过小样测试验证，因为工艺条件不受我们的控制，特别是在采用其他公司原料的地方更是如此。本文建议不排除用户调查的义务会侵害第三方权力，如有必要，应该澄清这种情况。使用建议不构成对该产品在某具体用途上的适当性或适合性的明示或暗示的担保。

管理体系受 ISO 16949 和 DIN EN ISO 14001 认证
EKagrip® 是 ESK Ceramics GmbH Co. KG. 的注册商标。

ESK Ceramics GmbH & Co. KG
Max-Schaidhauf-Straße 25
87437 Kempten, Germany
www.esk.com, info@esk.com